

B2 信息披露 Disclosure

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2020-082

博敏电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年11月16日以电子件和网络方式召开,于2020年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人,其中独立董事3人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长徐维先生召集并主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司章程修正案》等有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于对外投资的公告》(临2020-081)。

二、审议通过关于子公司对外投资的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于子公司对外投资的公告》(临2020-086)。

三、审议通过关于取消及调整部分募集资金投资项目的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于取消及调整部分募集资金投资项目的公告》(临2020-085)。

四、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2020-089)。

五、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2020-087)。

六、审议通过关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》(临2020-089)。

七、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2020-087)。

八、审议通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-091)。

特此公告。

(二)江苏大丰经济开发区管理委员会
对方名称:江苏大丰经济开发区管理委员会

单位性质:地方政府机构
法定代表人:沈炳南

地址:江苏省盐城大丰区南园西路606号
地址:江苏省盐城大丰区南园西路606号

三、投资标的的基本情况
1.项目内容
(1)乙方博敏决定在原电子电路板项目第一工厂建成投产的基础上,启动第二工厂建设,并在第一工厂基础上,新增厂房)不低于上地面积50%,容积率不低于0.9(多层不低于1.2),非生产性用房不超过总用地面积的5%。具体以规划部门规划图为准;主要条件:

(2)项目计划投资总额:玖仟(包括:土建厂房、设备投资、流动资金)。项目总投资建筑面积98万方,总建筑面积多层厂房(层高约23.9米)。项目全部建成投产,预计年产PCB板720万平方米,软硬结合板12万平方米。

项目用地约80亩,选址位于一期项目厂区西侧,土地性质为工业用地,土地使用约60年,面积以《国有建设用地使用权出让合同》为准。

三、项目投资主要要求
(一)乙方项目的一区、厂房设计和建筑应符合规划、国土等部门要求。具体为:建筑占地面积(含厂房、办公室、附属用房)不低于上地面积50%,容积率不低于0.9(多层不低于1.2),非生产性用房不超过总用地面积的5%。具体以规划部门规划图为准;主要条件:

(二)项目规划需经甲方规划部门审核后后方可进行建设规划、勘探、设计,并严格按照乙方施工、乙方须聘请的施工单位必须具备相应资质,确保在甲方规定的不低于工程审计价款的92%,并尽可能要求在开发区内设立公司,工程需进行监理和质量安全管理。

(三)乙方项目在生产安全、环境保护、劳动用工等方面应严格遵守国家及江苏省的相关法律法规。

(四)项目采用建设进度计划表,力争2020年底竣工投产,预计一年后将全部投产并启动投产。

四、对外投资合作的主要内容
(一)协议约定
甲方:江苏大丰经济开发区管理委员会
乙方:博敏电子股份有限公司

二、投资标的的基本情况
1. 优惠政策和配套服务
主要涉及项目为电子信息产业链项目,为支持电子信息产业发展,甲方给予乙方项目七年税收形成的大丰区财政(限增值税)不低于上地面积50%,容积率不低于0.9(多层不低于1.2),非生产性用房不超过总用地面积的5%。具体以规划部门规划图为准;主要条件:

(1)甲方为乙方购置生产设备(含进口设备和国产设备)给予增值税15%的设备补贴。乙方设备购置金额达到人民币5000万元(含)金额后,提供设备采购合同、设备发票、设备报关单、报关单、报关单等材料向甲方申请补贴,甲方在收到乙方相关材料且每次设备购置安装完成验收合格后个工作日内兑付。

(2)乙方项目在建设过程中,甲方给予乙方设备购置补贴。乙方购置设备清单、设备购置材料向甲方申请补贴,甲方在收到乙方相关材料后两个月内兑付补贴。设备购置补贴和建筑补贴,总计最高不超过20000万元。

(3)甲方负责供水、电、燃气、蒸汽供应等项目建设周期外,费用甲方自理。

(4)甲方协助乙方办理土地报批手续、环评、规划、消防、安全等相关手续,甲方在签订协议一个月后启动相关地勘、场地平整、完成水、电、气、燃气基础设施配套等工作,确保乙方开工日期如期开工。

(5)乙方为乙方处理污水,乙方自身污水处理中水回用率达到90%以上。

(6)乙方为乙方提供“一站式”服务,乙方在项目建设过程中,甲方在乙方发生任何工作日内,乙方提交本协议约定的材料向甲方申请补贴,甲方在收到乙方相关材料且每次设备购置安装完成验收合格后个工作日内兑付。

(7)任何一方对于不可抗力造成的损失或不能履行本协议书不负责任,但在条件允许下采取一切必要和合理的措施以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力事件,应在个工作日内将事件的情况和详情书面(或传真)通知对方,并可在事件发生后三个工作日内,另一方提交本协议约定的材料向甲方申请补贴,甲方在收到乙方相关材料且每次设备购置安装完成验收合格后个工作日内兑付。

(8)本协议生效后,甲乙双方应协商解决,协商不成,如提起诉讼由签约所在地人民法院管辖。

(9)本协议未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

(10)本合同双方约定代表人或授权代表签字并加盖公章的合同有效,具有法律效力。

五、对外投资对公司的影响
项目建成后,公司产能规模将得到提升,进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次投资符合公司的对外投资发展战略,不会导致公司的主营业务发生重大变化,不存在损害公司全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析
投资项目可能存在以下主要风险:

(一) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(二) 本次投资项目投资金额较大,可能对公司现金流造成一定影响,增加财务负担,资金能否按期到位存在不确定性。公司将根据项目进展情况,合理调配资金,同时,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(三) 本次投资项目投资金额较大,可能对公司现金流造成一定影响,增加财务负担,资金能否按期到位存在不确定性。公司将根据项目进展情况,合理调配资金,同时,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(四) 本次投资项目投资金额较大,可能对公司现金流造成一定影响,增加财务负担,资金能否按期到位存在不确定性。公司将根据项目进展情况,合理调配资金,同时,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2020年11月18日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2020-086

博敏电子股份有限公司关于取消及调整部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●根据公司业务实际情况,公司拟取消实施高精密印制电路板生产技术改造项目,调整高精密多层PCB产品产能;公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,原计划投入募集资金总额为124,477.52万元,现调整为82,245.40万元。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博敏电子”)于2020年11月17日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次审议通过了《关于取消及调整部分募集资金投资项目的议案》,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
博敏电子于2020年9月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]213号)关于非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的核准。本次发行实际发行数量为69,968,501股,发行价格为每股12.05元,共募集资金人民币94,299.90万元,扣除发行费用人民币2,485.49万元后,实际募集资金净额为人民币92,428.49万元。上述资金已于2020年11月11日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验[2020]13-112号”《验资报告》验证。

(二)募集资金使用计划调整
根据《博敏电子股份有限公司2020年度非公开发行股票A股募集说明书》,公司拟募集资金总额为不超过124,477.52万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金总额
1	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	98,260.00	54,103.00
2	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	34,200.00	33,240.00
3	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	33,000.00	33,000.00
4	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	37,400.00	33,000.00
合计		132,860.00	124,477.00

二、取消及调整部分募集资金投资项目的具体情况
(一)取消及调整部分募集资金投资项目
1.取消及调整部分募集资金投资项目基本情况
公司原计划募集资金总额124,477.52万元,用于高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目、高端印制电路板生产技术改造项目、研发中心升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次实际募集资金净额为82,245.40万元,相比计划有所减少,为提高募集资金使用效率,公司拟取消及调整部分募集资金投资项目,资金缺口由公司通过自筹方式解决。取消及调整后的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金总额
1	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	58,070.00	43,877.00
2	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	34,200.00	33,240.00
3	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	33,000.00	33,000.00
4	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	37,400.00	33,000.00
合计		132,670.00	124,477.00

其中,公司拟通过增资子公司江苏博敏电子有限公司的方式实施“高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目”。

2.取消及调整部分募集资金投资项目的实施和影响
公司根据本次实际募集资金的用途,本着客观、科学、审慎利用募集资金的原则,出于募集资金投资项目进度安排及实施效率的考虑,公司对募集资金投资项目、募集资金项目投入方案等方面进行相应的调整,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司整体盈利能力。

本次取消及调整不会改变公司使用募集资金,不会对公司日常的生产经营产生不利影响,不会对募集资金使用计划造成重大影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

三、取消及调整部分募集资金投资项目的决议程序
2020年11月17日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次审议通过了《关于取消及调整部分募集资金投资项目的议案》,公司独立董事对于以上事项发表了明确的独立意见。本次取消及调整部分募集资金投资项目不涉及关联交易。

四、本次取消及调整部分募集资金投资项目的实施
1.本次取消及调整部分募集资金投资项目,公司应根据实际募集资金金额小于计划募集资金金额的情况,在不损害公司及全体股东利益的前提下,依法依规履行相关程序,并尽快启动募集资金投资项目的实施。

2.本次取消及调整部分募集资金投资项目,公司应根据实际募集资金金额小于计划募集资金金额的情况,在不损害公司及全体股东利益的前提下,依法依规履行相关程序,并尽快启动募集资金投资项目的实施。

3.本次取消及调整部分募集资金投资项目,公司应根据实际募集资金金额小于计划募集资金金额的情况,在不损害公司及全体股东利益的前提下,依法依规履行相关程序,并尽快启动募集资金投资项目的实施。

4.本次取消及调整部分募集资金投资项目,公司应根据实际募集资金金额小于计划募集资金金额的情况,在不损害公司及全体股东利益的前提下,依法依规履行相关程序,并尽快启动募集资金投资项目的实施。

五、对外投资的风险分析
该项目可能存在以下主要风险:
(一) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(二) 本次投资项目投资金额较大,可能对公司现金流造成一定影响,增加财务负担,资金能否按期到位存在不确定性。公司将根据项目进展情况,合理调配资金,同时,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(三) 本次投资项目投资金额较大,可能对公司现金流造成一定影响,增加财务负担,资金能否按期到位存在不确定性。公司将根据项目进展情况,合理调配资金,同时,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(四) 本次投资项目投资金额较大,可能对公司现金流造成一定影响,增加财务负担,资金能否按期到位存在不确定性。公司将根据项目进展情况,合理调配资金,同时,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2020-085

博敏电子股份有限公司关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●投资标的名称:江苏博敏电子有限公司(以下简称“江苏博敏”)二期项目及
●投资金额:计划投资总额30亿元人民币
●投资风险:本次投资项目存在受宏观经济、行业周期等多种因素的影响,项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏博敏为进一步扩大业务规模,拟与江苏大丰经济开发区管理委员会签署《江苏博敏二期项目投资合同》(以下简称“本合同”),进一步提高产能档次,扩大产能,做大做强。项目为投资主体大、科技含量高的电子信息产业链项目,主要生产高端PCB板、软板、软硬结合板、集成电路载体、类载板、封装等,项目计划总投资金额为30亿元人民币。同时提请股东大会授权董事会有关法律法规和《公司章程》规定的范围内具体签署本合同对外投资协议。

(二)对外投资的审批程序
本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项,已经第四届董事会第五次会议审议通过,根据《公司章程》规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议后实施。

二、投资协议对双方的基本情况
对方名称:梅州市梅江区人民政府
法定代表人:李炳南
单位地址:梅州市梅江区城东东路51号
单位性质:地方政府机构
与公司的关系:公司与梅州市梅江区人民政府不存在关联关系。

(一)项目名称:博敏电子新一代电子信息产业扩建项目
(二)项目建设地点:广东增城(梅江)产业转移工业园(广东梅州经济开发区)
(三)项目投资方:博敏电子股份有限公司
(四)产品类型:电子产品制造,包括:高端印制电路板的生产、生产和销售等,主要产品:双面、多层、类载板、软硬结合板、集成电路载体、类载板、封装等。

(五)项目投资规模:计划投资总额30亿元人民币(其中,计划固定资产投资总额24亿元人民币以上)。
(六)投资进度:项目自投资之日起三年内实现首期投产,五年内实现全部建成投产,预计年产量300万平方米。

(七)市场地位及行业分析:
“十三五”以来,随着5G的全面铺开,高端印制电路板PCB的需求将持续高速增长。公司经过二十多年的积累和创新,具备技术领先优势,在PCB生产领域拥有先进的技术,已具备规模化、稳定、可靠地生产高端产品的能力。随着市场需求的进一步增长,公司高端PCB的技术不能总是跟随市场快速发展的需求,因此,公司需要进一步投入产品产能,提高产能占比,进一步提升高端市场需求。

本次项目投资有助于进一步扩大产品产能,提升公司产能,符合公司的战略发展方向,不会导致公司的主营业务发生重大变化,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析
该项目可能存在以下主要风险:
(一) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(二) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(三) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(四) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2020年11月18日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2020-085

博敏电子股份有限公司关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●投资标的名称:江苏博敏电子有限公司(以下简称“江苏博敏”)二期项目及
●投资金额:计划投资总额30亿元人民币
●投资风险:本次投资项目存在受宏观经济、行业周期等多种因素的影响,项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏博敏为进一步扩大业务规模,拟与江苏大丰经济开发区管理委员会签署《江苏博敏二期项目投资合同》(以下简称“本合同”),进一步提高产能档次,扩大产能,做大做强。项目为投资主体大、科技含量高的电子信息产业链项目,主要生产高端PCB板、软板、软硬结合板、集成电路载体、类载板、封装等,项目计划总投资金额为30亿元人民币。同时提请股东大会授权董事会有关法律法规和《公司章程》规定的范围内具体签署本合同对外投资协议。

(二)对外投资的审批程序
本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项,已经第四届董事会第五次会议审议通过,根据《公司章程》规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议后实施。

二、投资协议对双方的基本情况
对方名称:梅州市梅江区人民政府
法定代表人:李炳南
单位地址:梅州市梅江区城东东路51号
单位性质:地方政府机构
与公司的关系:公司与梅州市梅江区人民政府不存在关联关系。

(一)项目名称:博敏电子新一代电子信息产业扩建项目
(二)项目建设地点:广东增城(梅江)产业转移工业园(广东梅州经济开发区)
(三)项目投资方:博敏电子股份有限公司
(四)产品类型:电子产品制造,包括:高端印制电路板的生产、生产和销售等,主要产品:双面、多层、类载板、软硬结合板、集成电路载体、类载板、封装等。

(五)项目投资规模:计划投资总额30亿元人民币(其中,计划固定资产投资总额24亿元人民币以上)。
(六)投资进度:项目自投资之日起三年内实现首期投产,五年内实现全部建成投产,预计年产量300万平方米。

(七)市场地位及行业分析:
“十三五”以来,随着5G的全面铺开,高端印制电路板PCB的需求将持续高速增长。公司经过二十多年的积累和创新,具备技术领先优势,在PCB生产领域拥有先进的技术,已具备规模化、稳定、可靠地生产高端产品的能力。随着市场需求的进一步增长,公司高端PCB的技术不能总是跟随市场快速发展的需求,因此,公司需要进一步投入产品产能,提高产能占比,进一步提升高端市场需求。

本次项目投资有助于进一步扩大产品产能,提升公司产能,符合公司的战略发展方向,不会导致公司的主营业务发生重大变化,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析
该项目可能存在以下主要风险:
(一) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(二) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(三) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(四) 虽然项目符合国家和地方政策及市场发展需求,但由于市场本身存在不确定因素,若未来市场发展情况低于预期,则可能导致项目收益不达预期,存在投资风险。因此,公司将加大项目市场调研和投入管理,在项目实施过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

有限公司持有16.7%的股权。

截至2020年12月31日,江苏博敏资产总额996,360.23万元,负债总额为71,091.19万元,净资产为26,269.04万元,2019年实现营业收入9,641,600.84万元,净利润为3,144.83万元。(以上数据经审计)

截至2020年9月30日,江苏博敏资产总额为104,474.77万元,负债总额为69,080.26万元,净资产为35,394.51万元,2020年第三季度实现营业收入9,539,640.51万元,净利润为5,125.47万元。(以上数据未经审计)

(三)本次增资的目的及对公司的影响
江苏博敏电子控股子公司,本次增资系公司对控股子公司增资,目的是为了公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目“高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目”实施的需要,募集资金的公开方式,用途符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远利益,有利于提升公司整体竞争力及提升核心竞争力,促进公司健康快速发展,符合公司全体股东的利益,不会对上市公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事、监事会、保荐机构意见
1.独立董事意见
本次募集资金投资项目符合国家产业政策,资金来源为公司2020年度非公开发行之募集资金。江苏博敏在进一步增资后,将用于公司募集资金投资项目“高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目”的实施,并开展募集资金专户管理、集中管理相关募集资金。上述事项符合公司募集资金用途范围,符合公司及股东利益,同意公司募集资金向江苏博敏增资43,847.49万元以推进募集资金项目顺利实施。

二、监事会意见
公司对对外投资于江苏博敏增资方式实施募集资金投入,符合公司2020年度非公开发行股票募集资金使用计划,有利于稳步推进募集资金项目,确保公司持续快速的发展。本次增资符合江苏博敏募集资金用途的范围,同意公司募集资金对江苏博敏增资。

3.保荐机构意见
公司拟于2020年度非公开发行股票募集资金对控股子公司江苏博敏增资有利于募投项目的开展和顺利实施,上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向,不存在损害股东利益的情况;该事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次审议通过,独立董事亦发表了明确的独立意见,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2018修订)》等相关文件的规定。保荐机构同意公司募集资金43,847.49万元增资江苏博敏。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2020年11月18日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2020-088

博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●募集资金使用方式:商业性银行、证券公司、资产管理公司等金融机构
●本次现金管理金额:最高不超过60,000万元人民币,在上述额度内公司可循环使用,滚动使用。
●投资品种:低风险、安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
●资金管理期限:自公司董事会审议通过之日起一年内。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博敏电子”)于2020年11月17日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下于十二个月内滚动实施。

一、本次募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
博敏电子于2020年9月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]213号)关于非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的核准。本次发行实际发行数量为69,968,501股,发行价格为每股12.05元,共募集资金人民币94,299.90万元,扣除发行费用人民币2,485.49万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币92,428.49万元。上述资金已于2020年11月11日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验[2020]13-112号”《验资报告》验证。

(二)募集资金使用计划调整
根据《博敏电子股份有限公司2020年度非公开发行股票A股募集说明书》,公司拟募集资金总额为不超过124,477.52万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金总额
1	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	98,260.00	54,103.00
2	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	34,200.00	33,240.00
3	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	33,000.00	33,000.00
4	高精密多层印制电路板生产技术改造项目	37,400.00	33,000.00
合计		132,860.00	124,477.00

其中,公司拟通过增资子公司江苏博敏电子有限公司的方式实施“高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目”。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)募集资金使用目的
本募集资金投资项目,为提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,拟将最高总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的价值增值。

(二)资金来源
公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

(三)资金管理期限
为控制风险,本次现金管理使用部分闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理不得用于质押,不得实施与募集资金使用目的相违背的行为。

(四)投资品种及期限
公司本次现金管理的投资品种为不超过60,000万元,期限为本次公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起二个月,在规定的额度内,资金可滚动使用。

(五)实施方式
公司将根据授权董事长及董事长授权人在规定的额度范围内具体负责组织实施。

公司将根据授权董事长及董事长的授权人在规定的额度范围内具体负责组织实施。

公司将根据授权董事长及董事